

苏州国芯科技股份有限公司

2022 年 10 月投资者关系活动记录表

证券简称：国芯科技

证券代码：688262

编号：2022-010

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	红杉资本：闫慧辰； 中信集团：王源； 易方达基金：曹粤； 平安基金：唐煜； 嘉实基金：谢泽林； 凯石基金：陈晓晨； 诺安基金：丁云波； 中加基金：吕航； 中金资本：邹臣； 华泰柏瑞基金：刘志清； 国泰君安：陈豪杰、舒迪、肖凯； 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司：吕伟志； 君榕资产：汪质彬； 昭图投资：王子杰； 惠通基金：王青晨； 中信保诚基金：杨柳青； 中信建投基金：周户； 华商基金：郭磊； 万家基金：陈飞达； 北大方正人寿保险有限公司：孟婧； 中金基金：汪洋；

敦和资产：章宏帆；
利幄资产：孟舒豪；
华泰保兴基金：符昌铨；
招商证券：刘怡君；
煜德投资：陈启航；
鹤禧投资：李峥嵘；
建信信托：吴晓鹏；
Parantoux Capital Limited：许晴晖；
海南拓璞私募基金管理有限公司：邹辰；
财信证券：何晨；
海南进化论私募基金管理有限公司：刘迪；
丰琰投资：孙啸；
Prudence Investment Management (Hong Kong) Ltd.（方圆投资管理（香港）有限公司）：
董丰侨；
北京合创友量私募基金管理有限公司：王艺璇；
中华联合保险：李东；
Taikang Asset Management (HK) Company Limited（泰康资产管理（香港）有限公司）：
Kane Chen；
衍航投资：庞宇超；
泰旻资产：潘乐秀；
重阳投资：李立源；
景泰利丰投资：吕伟志；
中科沃土基金：黄艺明；
长江证券：冯源；
金恒宇投资：张旭；
中信建投：乔磊、王凤娟；
安瑞置业：陈媛；
中信保诚基金：郑弼禹；
志开投资：王浩然；

	个人投资者：CHEN QIUMING、侯恒星。
时间	2022年10月28日10:00 2022年10月28日15:00
地点	线上交流
上市公司参加人员姓名	董事长：郑荏先生 董事会秘书：黄涛先生 证券事务代表：龚小刚先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者就其关心的问题，向公司提出了问题，公司参会人员进行了回复，主要情况如下：</p> <p>1、请介绍一下前三季度的业绩情况？</p> <p>答：截至2022年9月30日，公司的营收达到3.22亿元人民币，同比增长21.78%；归属上市股东的净利润达到9,664.76万元人民币，同比增长163.98%；扣非后净利润达3,737.45万元人民币，与上年同期相比49.14%。</p> <p>2、前三季度业绩变动的主要原因是什么？</p> <p>答：对比上年同期，本报告期内公司持续调整产品结构，抓住行业发展机遇，围绕国家重大需求、汽车电子和云安全应用等重点领域，积极开拓市场和客户，克服疫情带来的影响，有效保障产能需求，使得公司营业收入实现了持续增长。另外，本报告期公司理财收益与政府补贴比上年同期有较大幅度的增长。</p> <p>3、公司在汽车电子上的布局怎么样？最新进展如何？</p> <p>答：在汽车电子芯片领域，公司的芯片产品覆盖面较全，已在多个方向上实现产品系列化，继续与科世达（上海）管理有限公司、埃泰克汽车电子（芜湖）有限公司等一批汽车电子领域头部客户保持良好的合作关系，汽车电子车身控制芯片和动力总成控制芯片采用和国内头部车身控制模组厂商、发动机厂商协同创新的合作方式，在产品开发阶段就受到国内汽车整机厂商和Tier1汽车电子模组厂商的关注和订单支持，形成公司汽车电子芯片产品的先发优势，并获得了市场的认可和良好的业界口碑，公司致力于成为国内汽车电子芯片的领先供应商。2022年10月，国芯科技建设的“江苏省汽车电子芯片工程研究中心”被认定为2022年江苏省工程研究中心。具体布局及进展包括：</p>

(1) 汽车车身控制芯片领域：公司于 2022 年上半年推出的 CCFC2012BC 中高端车身及网关控制芯片，可对标国外产品如 NXP（恩智浦）MPC5604BC、MPC5607B 系列以及 ST（意法半导体）的 SPC560B50、SPC560B64 系列，受到市场的普遍欢迎，订单增加较快，客户包括多家 Tier1 模组厂商和国内主要的汽车品牌厂商，该芯片采用自主可控的 PowerPC 的指令集。截至 2022 年 9 月底，公司研发成功的新一代中高端车身/网关控制芯片已经获得超过 200 万颗订单，并实现超过 130 万颗出货和装车，应用场景包括整车控制、车身网关、安全气囊、无钥匙启动及 T-BOX 等应用，可实现对国外同类产品的替代，覆盖新能源车和传统乘用车等。目前下游的涵盖整车客户包括比亚迪、上汽、长安、奇瑞、东风等，预计随着公司产品前装应用量增加和影响力增加，芯片的订单及出货增长量会进一步增加。

(2) 汽车动力总成控制领域：公司已研发成功 CCFC2003PT、CCFC2006PT 等型号芯片产品，其中 CCFC2003PT 对标 NXP（恩智浦）MPC5634、CCFC2006PT 对标 NXP（恩智浦）MPC5554，并已在重型发动机中获得实际应用，对标 NXP（恩智浦）MPC5674 的 CCFC2007PT 已经内部测试成功，对标 NXP（恩智浦）MPC5777 的 CCFC3007PT 芯片产品正在设计中，可覆盖传统的汽柴油发动机、新型混动发动机及电动机应用需求。动力总成控制芯片需要更长的时间进行应用验证，公司目前正在和相关厂商紧密合作，争取尽快实现产业化规模应用。目前国内能开展汽车动力总成控制芯片研发的厂商还很少，公司在国内处于领先地位。公司构建了和汽车发动机领域头部客户和动力总成控制模组头部厂商为主要的战略合作关系格局，共同定义新产品，实现国产化替代。汽车发动机芯片技术难度大，但市场急需国产化。

8 月 31 日，公司发布公告披露了公司成功研发的 CCFC2007PT 芯片产品，是基于公司自主 PowerPC 架构 C*Core CPU 内核研发的新一代汽车电子动力总成及新能源电池管理 (BMS) 控制芯片，是在已有 CCFC2006PT 芯片基础上根据客户需求对功能的进一步增强和完善。该芯片基于 40nm eflash 工艺开发和生产。CCFC2007PT 芯片按照汽车电子 Grade1 等级进行设计和生产，具有高可靠性，可以应用于苛刻的使用场景，从而增加了产品的应用覆盖面，封装形式包括 BGA516/BGA324/LQFP216/LQFP144 等，可以广泛应用于汽、柴油车动力总成和新能源电池管理，有望为解决我国汽车和新能源产业“缺芯”问题作出贡献。

(3) 汽车域控制器领域：公司正在开发汽车域控制器芯片 CCFC2016B，进展顺利，目前已经完成流片，该芯片的产品定义过程中充分征求了国内头部新能源汽车厂商的意见。同时，我们也正在研发高端的域控制芯片 3007PT。

(4) 新能源电池 BMS 控制领域：8 月 31 日，公司公告披露了公司成功研发的 CCFC2007PT（中端的 BMS 芯片）芯片产品，可以应用于新能源电池管理(BMS)控制芯片。同时，公司正在开展新能源电池管理控制芯片 CCFC3008PT 的研发，进展顺利。

(5) 车规级安全 MCU 芯片：公司已成功开发 CCM3310S-T、CCM3310S-H 和 CCM3320S 等三款汽车电子安全芯片产品，形成高、中、低产品系列，其中 CCM3310S-T/CCM3310S-H 已批量供货，CCM3320S 正在进行客户验证阶段，主要对标国际领先厂商有恩智浦和英飞凌相关产品，主要应用包括车载 T-BOX 安全单元、车载诊断系统（OBD）安全单元、车联网 C-V2X 通信安全应用等；

在其他应用领域，公司也开始瞄准汽车电子电源管理类芯片领域国产化替代机会，启动汽车门控混合信号芯片 CCL1100B 的研发以及安全气囊点火芯片、降噪芯片等的研发工作。

受国家对汽车产业政策带动、汽车缺芯、国产替代等因素的大力推动，今年国产汽车芯片需求继续旺盛。就汽车电子 MCU 整个市场情况，有第三方数据显示到 2026 年，中国的 32 位 MCU 的市场大概是 50 亿美金，海外市场可能会到 150 亿美金，整个市场，不论国内还是海外，都处在增长的时期。公司汽车电子芯片的客户包括埃泰克、科世达等 10 多家的模组厂商，潍柴动力等多家发动机厂商，和比亚迪、长安、奇瑞、上汽和东风等众多汽车整机厂商，公司与下游客户有较为紧密的合作。

4、公司目前的产能情况怎么样？

答：公司与下游晶圆厂维持非常良好的合作关系，能保证晶圆产能的获得，以实现公司确定的销售目标。

5、智能门锁、金融 POS 等业务，受疫情影响大吗？是否有复苏迹象？

答：智能门锁、POS 机整个市场受房地产、疫情、商业景气度影响，今年前三季度影响较大，四季度有所恢复，预计明年应该会有更好的恢复。

6、请介绍一下公司信创领域相关产品情况？

答：公司信创领域的产品主要包括云应用芯片和端应用芯片。

云应用芯片包括云安全芯片、存储控制 Raid 芯片和边缘计算芯片，具体包括：（1）云安全芯片产品，主要面向服务器、VPN 网关、防火墙、路由器、密码机、智能驾驶路测设备、视频监控、电力隔离设备、可信计算和 5G 基站等领域，公司目前正在根据原有产品 CCP907T 用户使用反馈，在 PCIE 控制器升级、安全算法性能的提升、总线频率的提升、SEC 安全引擎增强、IPSEC 特定应用场景下的硬件加速、支持不同应用场景下的功耗控制优化等方面进行改进；（2）RAID 控制器芯片，主要面向服务器应用，可以为客户提供灵活可靠、大容量存储资源管理，基于公司自主 C*Core CPU 内核 C8000 研发的一款磁盘阵列控制芯片，具备多个独立的接口通道支持连接最多 40 个机械硬盘或 SSD 固态存储盘，兼容 PCIE 标准开发，实现数据的高可靠、高效率存储及传输管理，具有全面的 RAID 数据保护机制，提供 RAID0/1/5/6/10/50/60 模式，实现阵列管理软件功能；（3）边缘计算、安全和网络通信集成处理控制器芯片，主要用于边缘计算和通用嵌入式计算中的综合控制、安全处理、数据通路、应用层处理和微服务器主控，正在研发的多款新产品采用国芯 32 位或 64 位四核的 PowerPC 指令架构 CPU 核，集成高性能密码算法引擎和网络数据加速引擎，具有千兆网、万兆网、PCIe3.0、USB3.0、RapidIO2.0 等高速接口。

在信创领域，除以上云应用芯片外，公司的端应用芯片包含身份认证、数字签名、数据加解密及可信计算等功能，多款产品通过相关部门安全认证，已应用于信创 PC、打印机和电子钥匙等领域等。

7、公司在数字人民币上的布局怎么样？

答：在数字货币方面，公司云、端安全芯片包含身份认证、数字签名、数据加解密及通信接口等功能，产品通过相关部门安全认证，可以用于基于数字人民币的数字钱包、交易机具及后台安全服务等。主要客户涵盖数字钱包、交易机具及后台服务厂商，公司主要提供芯片、基于芯片的模组，并与客户联动开展新一代芯片产品开发，CCM4202S-EL 是根据市场反馈，基于原 CCM4202S-E 增加了内部存储容量，拓展了满足数字货币场景应用的功能，目前该芯片完成设计，工程批正在流片中。

	<p>8、怎么理解公司的边缘计算业务，公司在边缘计算业务上是怎么布局的？</p> <p>答：随着物联网、5G 等技术的飞速发展，可穿戴设备、移动智能终端、智能网联汽车和机器人等设备产生海量的数据，并且普遍要求数据处理的低时延和高可靠性，云计算集中式的大数据处理模式有时候不能完全满足需求，在某些领域边缘计算的运行效率可能更高。边缘计算使数据能够在最近端进行处理，减少云、端间的数据传输，极大提升效率，很适合高交互、大带宽的 5G 时代。此外，在对数据采集和传输日益敏感的环境下，边缘计算本地化处理数据为企业安全合规带来很大便利。公司边缘计算芯片目前首先针对信创领域应用进行布局，主要包括：</p> <p>高性能边缘计算、安全和网络通信集成处理控制器芯片 H2040，基于 28nm 工艺设计，采用国芯 32 位四核的 PowerPC 指令架构 CPU 核，集成 DDR3.0、PCIe3.0、千兆网、SATA2.0、RapidIO2.0 等接口，已完成流片，芯片测试应用中，主要用于边缘计算和通用嵌入式计算中的综合控制、安全处理、数据通路和应用层处理。在此基础上，公司基于 14nm 工艺开发了新一代高性能边缘计算、安全和网络通信集成处理控制器芯片 H2048/H2068，增加了高级数据链路控制协议引擎等。</p> <p>高性能边缘计算、安全和网络通信集成处理控制芯片 S1020，基于 14nm 工艺设计，采用国芯 64 位多核 PowerPC 架构 CPU 核，集成高性能密码算法引擎、网络数据加速引擎、高性能 RAID 算法引擎等，具有万兆网、PCIe3.0、USB3.0 等高速接口，设计中，可实现对国外产品如 NXP 的 T2040 系列相应产品的替代，主要用于边缘计算、网关、VPN、微服务器等设备的主控芯片。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2022 年 10 月</p>